

Sintertechnologie – Ein Überblick



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 4,39 €

4,70 €

Netto-Preis: 4,39 €

Enthaltene MwSt.: 0,31 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung Im 1. Teil des Übersichtsbeitrags zu Fügeverfahren aus dem Technologiebereich Sintern, die in der Elektronikfertigung eingesetzt werden (PLUS 10[2020, S. 1353 ff), wurde vor allem der Sinterprozess an sich erläutert. Hier in Teil 2 werden erkennbare Trends und technologische Merkmale näher betrachtet und ausgewertet, um die Einflussgrößen auf die Verfahrenstechnik und letztendlich auf die Zuverlässigkeit der hochtemperatur-geeigneten Fügetechnik zu erfassen. Zudem geht es um Technologievarianten. Part 1 of this overview article on joining processes from the technology area of sintering used in electronics manufacturing (PLUS 10[2020, p. 1353 ff), above all explained the sintering process itself. Part 2 evaluates visible trends and technological features in detail to determine the influencing variables on the process technology and examines the reliability of the joining technology suitable for high temperatures. In addition, it also deals with technology variants.